

日月光一〇六年度第二季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 106 年 7 月 28 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇六年度第二季獲利報告，本公司一〇六年第二季之合併營業收入較一〇六年第一季下滑 1%，較一〇五年同期成長 5%，為新台幣 66,026 百萬元。茲將日月光一〇六年度第二季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	106 年度 第二季	106 年度 第一季	105 年度 第二季
營業收入淨額	66,026	66,551	62,601
營業毛利	12,116	11,975	12,254
營業淨利（淨損）	5,219	5,225	5,889
稅前淨利（淨損）	11,390	3,845	6,080
所得稅利益（費用）	(3,207)	(886)	(1,523)
非控制權益	(336)	(400)	(255)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	7,847	2,559	4,302
基本每股盈餘(新台幣元)	0.97	0.33	0.56
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.89	0.29	0.47

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	106 年度 第二季	106 年度 第一季	105 年度 第二季
營業收入淨額	39,048	38,385	38,504
營業毛利	9,027	8,833	9,559
營業淨利（淨損）	4,102	3,983	4,915
稅前淨利（淨損）	9,462	3,207	5,608
所得稅利益（費用）	(1,541)	(570)	(1,266)
非控制權益	(74)	(78)	(40)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	7,847	2,559	4,302

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	48
電腦	11
汽車, 消費性電子及其它	41
前十大客戶佔營收比重	47

測試業務產品組合	%
後段測試	83
晶圓測試	14
前段測試	3
測試資本支出金額	47 百萬美元
測試機台數	3,796 台

封裝業務產品組合	%
Bumping, Flip Chip, WLP & SiP	31
IC Wirebonding	58
Discrete and Others	11
封裝資本支出金額	161 百萬美元
打線機台數	16,118 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	48
電腦	17
消費性電子	20
工業用	8
汽車電子	6
其它	1
前十大客戶佔營收比重	89
EMS 資本支出金額	4 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2017 年第三季的業績展望如下：

- 半導體封測事業第三季生意量將小幅低於去年第三季水準；
- 半導體封測事業第三季毛利率將相當於去年第二季水準；
- 電子代工服務第三季生意量將相當於去年第三季與第四季之平均；
- 電子代工服務毛利率將相當於去年第一季與第二季之平均。